

보도자료

알카이머 – 달사 반도체, 구리 TSV 로 MEMS 공정을 위한 eG ViaCoat™ 기술 라이선스 계약 체결

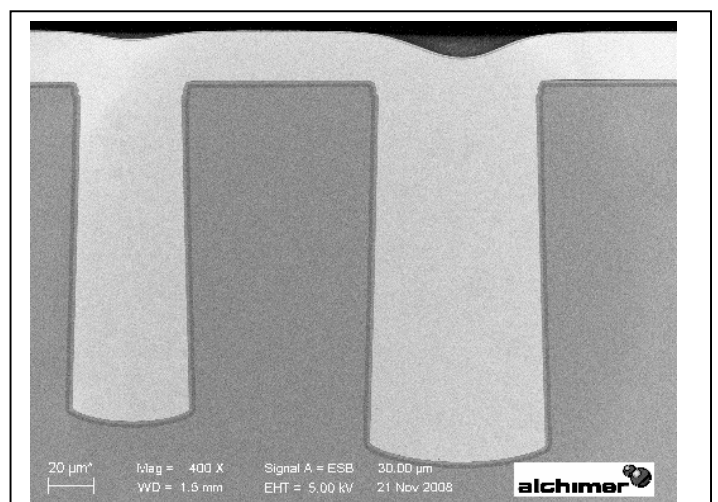
2008년 12월 16일 – 나노메트릭 TSV(through-silicon via) 금속화 기술 개발 업체인 알카이머(Alchimer S.A.)는 달사 (DALSA Corporation, TSX: DSA)의 사업부이자 주문형 웨이퍼 파운드리 서비스 전문업체인 달사 반도체(DALSA Semiconductor)가 자사의 eG ViaCoat™ 공정을 이용한 TSV 에서 컨포멀 (conformal: 등각) 구리 씨드 층 제조 테스트에 성공했다고 발표했다. 이 같은 성공적인 테스트 결과로, 달사는 MEMS 생산력을 증대시킬 수 있는 알카이머의 기술을 라이선스 하기로 했다.

달사 반도체의 루크 올레 (Luc Ouellet) 기술 개발 부사장(VP)은 “ 몇 년 동안, 달사 반도체는 3D 통합 기술에 적합한 비어-퍼스트 (via-first) TSV 방식을 이용해 저가의 MEMS 제품을 가공해왔다”면서 “알카이머의 구리 기반 eG ViaCoat 방식을 이용하면, 우리는 고속 동작 주파수, 더욱 낮은 저항에도 불구하고 더욱 높은 전력 밀도, TSV 를 통한 고열 발산의 기술적 특징으로 고객들에게 MEMS 제품을 지원할 수 있다. 알카이머의 TSV 방식은 가격에 민감한 시장에서 MEMS 디바이스를 대량 생산할 수 있게 하는 전략적인 기술이다”라고 말했다.

알카이머의 eG ViaCoat 는 고성능 3D 패키징 애플리케이션에서 사용되는 TSV 의 구리 씨드 금속화를 위한 전기화학 코팅 공정이다. eG ViaCoat 는 건식 진공 공정 대비 CoO(cost of ownership) 를 50% 이상 감소시킬 수 있다. eG ViaCoat 는 세미콘 웨스트 2008 전시회에서 최고 상인 “Best of the West Award”를 수상하기도 했다.

달사와 라이선스 계약을 체결하기 위해, 알카이머는 깊이가 깊은 오목형 (reentrant) TSV 에서 제품 성능 범위를 성공적으로 시연했다. 오목형 TSV 는 바닥보다 기판의 표면에서 직경이 더욱 좁은 형태이다. 이것은 보쉬 (Bosch)의 고속 DRIE (deep reactive ion etching) 공정으로 생산된 독특한 형태이다. eG ViaCoat 는 오목형 구조에서 우수한 단계 커버리지를 시연할 수 있기 때문에, 보쉬의 고속 식각 공정이 사용될 수 있으며, 최고 50%까지 DRIE 단계의 비용을 절감시킨다. 따라서, 구리 씨드 금속화 단계에서 이루어지는 비용 절감에 이어 고속 DRIE 단계에서도 추가적으로 비용이 절감된다. 알카이머는 깊이가 깊은 오목형 TSV 구조에서 그 다음 단계의 보이드프리 구리 필을 성공적으로 시연하기도 했다.

알카이머 스티브 러너(Steve Lerner) CEO 는 “MEMS 파운드리 산업 선도업체이면서 혁신적인 기술 및



알카이머의 eG ViaCoat 공정은 달사 반도체의 TSV 에 적합한 고속 처리율의 깊이가 깊은 오목형 테스트 구조에서 완벽한 보이드프리 (void-free) 구리 필을 따르는 구리 씨드 층을 만든다.

고품질 제품 제공하는 달사와 협력하게 되어 매우 기쁘다”라고 말했다.

Alchimer 회사소개

Alchimer 는 반도체 웨이퍼 및 3D 패키징용 TSV 에서 구리 연결을 형성하는데 쓰이는 나노메트릭 필름의 전기화학 증착용 화학 제형 및 공정 전문 개발업체이다. 이 회사는 Commissariat à l’Energie Atomique 에서 분사했다. 2001 년에 설립된 Alchimer 는 프랑스 연구 산업 장관으로부터 첨단기업에 주어지는 최초의 국가상(First National Award for the Creation of High Tech Companies)을 받았으며, Red Herring Top 100 European Company 이기도 하다. 자세한 내용은 홈페이지 www.alchimer.com 참조.

DALSA Corporation 회사소개

DALSA 는 고성능 디지털 이미징 및 반도체 분야의 세계적인 선도업체로 전세계에 약 1,000 명의 직원이 활동하고 있다. 1980 년에 설립된, 이 회사는 디지털 이미징 제품 및 솔루션을 설계, 개발, 제조, 공급하면서, 반도체 제품과 서비스도 함께 제공하고 있다. DALSA 의 핵심 경쟁력은 집적회로 및 전자 기술, 소프트웨어를 비롯해 첨단 반도체 웨이퍼 공정 기술이다. DALSA 는 이미지 센서 부품 (CCD 및 CMOS), 전기 디지털 카메라, 비전 프로세서, 이미지 프로세싱 소프트웨어, MEMS 에서 사용되는 반도체 웨이퍼 파운드리 서비스, 고전압 반도체, 이미지 센서, 혼합신호 CMOS 칩을 공급한다. DALSA 는 “DSA” 심볼로 토론토 주식 거래소에 상장되었으며, 캐나다 온타리오주 워터루에 위치해 있다.

달사 회사 문의:

Patrick Myles
Vice President, Corporate Communications
DALSA Corporation
Tel: (519) 886-6001 Ext. 2177
Fax: (519) 886-3972
E-mail: patrick.myles@dalsa.com
Web: www.dalsa.com

알카이머 본사 문의:

Emmanuel Guidotti
Alchimer S.A., 15 rue du Buisson aux Fraises, F-91300 Massy, France
E-mail: emmanuel.guidotti@alchimer.com
Tel: +33 1 69 75 43 43
Fax: +33 1 60 11 07 52
Web: www.alchimer.com